

JASDAQ
Listed Company 6323

SEMICON
Taiwan 2006

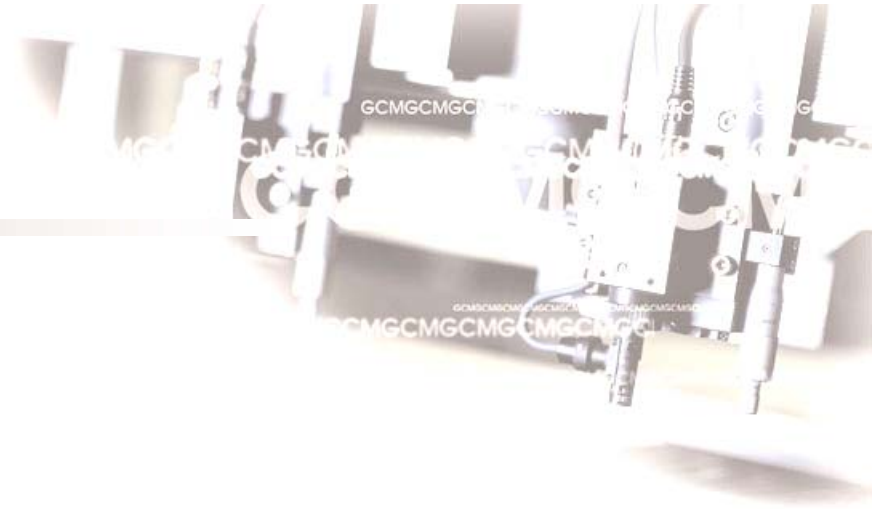
Organized by:
semi
Co-Organized by:
TAITRA
Endorsed by:
TSIA

2007年2月期中間決算説明会資料

2006年10月25日

RORZE CORPORATION

RORZE



2007年2月期 中間決算概要

2007年2月期 中間連結損益計算書

(百万円)

	2006年2月期 中間実績	2007年2月期 中間実績	前年同期比	増減理由等
売上高	4,205	6,742	160.3%	<ul style="list-style-type: none"> ・国内半導体メーカーの微細化に向けた新規設備投資の他、海外の積極的な新規設備投資の増加 ・韓国・台湾など海外を中心としたガラス基板搬送装置関係の受注増加
売上総利益	1,177	1,862	158.2%	<ul style="list-style-type: none"> ・売上の大幅増加 ・台湾子会社の現地生産体制整備による生産効率の改善、韓国子会社の生産能力アップ、ベトナム生産子会社の量産体制確保等 ・原価率(72.0% → 72.4%)
販管費	827	1,012	122.4%	<ul style="list-style-type: none"> ・販売体制の強化、開発研究費の増加等 ・販管费率(19.7% → 15.0%)
営業利益	350	850	242.6%	
経常利益	302	843	279.2%	(営業外損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)
中間純利益	141	500	352.5%	(特別損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)

2007年2月期 中間連結貸借対照表 (百万円)

	2006年2月期 中間実績	2007年2月期 中間実績	増減	増減理由等
流動資産	9,417	10,654	1,237	・売上増加に伴う受取手形及び売掛金増加 +919
固定資産等	8,193	8,951	757	・韓国子会社新工場建設等に伴う建物 及び構築物、土地等増加 +1,287 ・建設仮勘定減少 Δ 829 ・韓国子会社長期性定期預金 (投資その他の資産「その他」)の増加 +121
資産合計	17,610	19,606	1,995	
流動負債	6,272	7,748	1,475	・売上、受注増加に伴う支払手形及び 買掛金増加 +700 ・利益増加による未払法人税増加 +177
固定負債	4,130	3,169	Δ 960	・長期借入金減少 Δ 977
負債合計	10,403	10,918	515	
少数株主持分	1,334	—	Δ 1,334	
資本合計	5,873	—	Δ 5,873	
負債・資本合計	17,610	—	Δ 17,610	
純資産合計	—	8,687	8,687	・主に韓国子会社少数株主持分相当 +259 ・利益剰余金増加 +906 ・為替換算調整勘定 +245
負債及び純資産合計	—	19,606	19,606	

2007年2月期 中間連結キャッシュ・フロー

(百万円)

	2006年2月期 中間実績	2007年2月期 中間実績	増 減
営業活動による キャッシュ・フロー	292	91	△200
投資活動による キャッシュ・フロー	△534	△301	232
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 693	△558	135
現金及び現金同等物 に係る換算差額	41	23	△18
現金及び現金同等物 の増減額	△893	△744	148
現金及び現金同等物 の期首残高	2,384	2,235	△148
現金及び現金同等物 の期末残高	1,490	1,491	0

2007年2月期 単体中間損益計算書

(百万円)

	2006年2月期 中間実績	2007年2月期 中間実績	前年同期比	増減理由等
売上高	3,365	4,382	130.2%	・国内及び海外に於ける半導体・液晶の新規設備投資増加
売上総利益	711	925	130.1%	・売上高増加 ・電子部品材料(DRAM、フラッシュメモリー、液晶パネル等)の低価格化に伴う値引要請等 ・原価率(78.9% → 78.9%)
販管費	512	523	102.2%	・開発強化に伴う開発研究費増加 ・一方、コスト削減効果等により、総額では微増 ・販管费率(15.2% → 11.9%)
営業利益	198	401	202.4%	
経常利益	163	374	228.7%	(営業外損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)
中間純利益	93	213	227.8%	(特別損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)

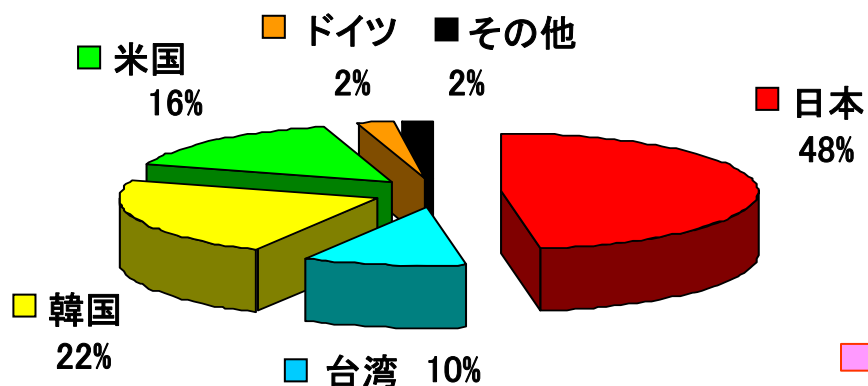
2007年2月期 単体中間貸借対照表

(百万円)

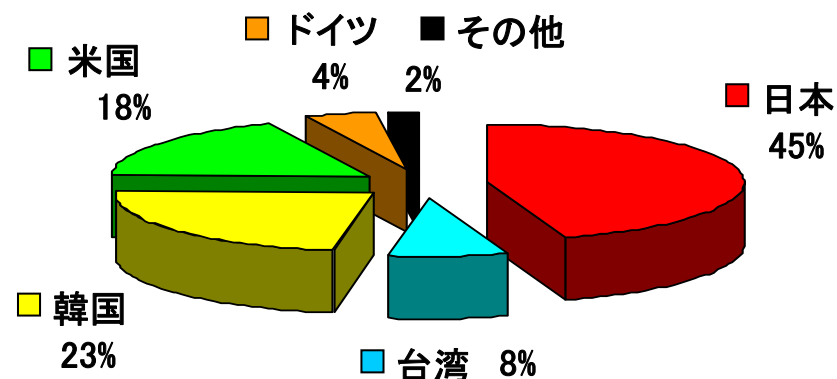
	2006年2月期 中間実績	2007年2月期 中間実績	増減	増減理由等
流動資産	7,123	7,611	488	・売上増加に伴う受取手形及び 売掛金増加 +748 ・棚卸資産圧縮 Δ260
固定資産	8,406	8,190	Δ216	・工具器具備品等の増加、 並びに通常償却による減少 Δ120 ・関係会社長期貸付金 Δ108
資産合計	15,530	15,802	272	
流動負債	6,054	7,154	1,099	・売上、受注増に伴う支払手形 及び買掛金増加 +727 ・短期借入金増加 +161 ・利益増加による未払法人税増加 +121
固定負債	3,194	2,131	Δ1,062	・長期借入金減少 Δ1,045
負債合計	9,249	9,286	36	
資本合計	6,280	—	Δ6,280	
負債・資本合計	15,530	—	Δ15,530	
純資産合計	—	6,516	6,516	・別途(任意)積立金増加 +150
負債及び純資産合計	—	15,802	15,802	

海外売上高(連結)

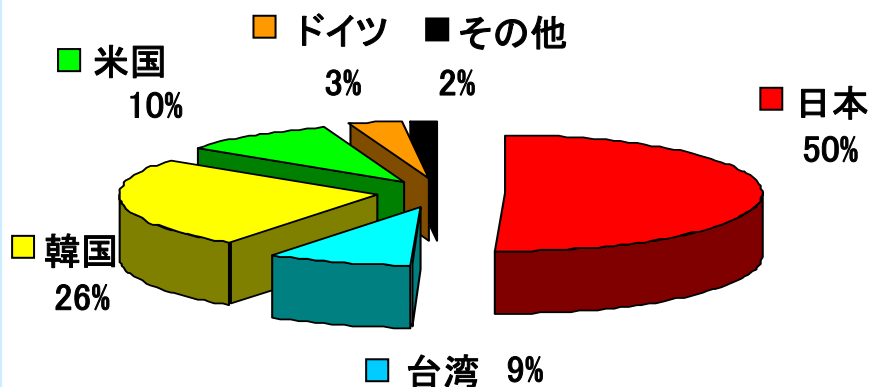
2004年2月期中間



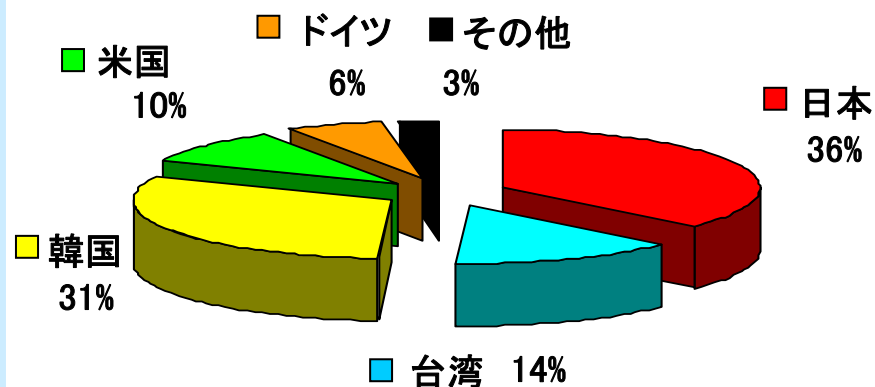
2005年2月期中間

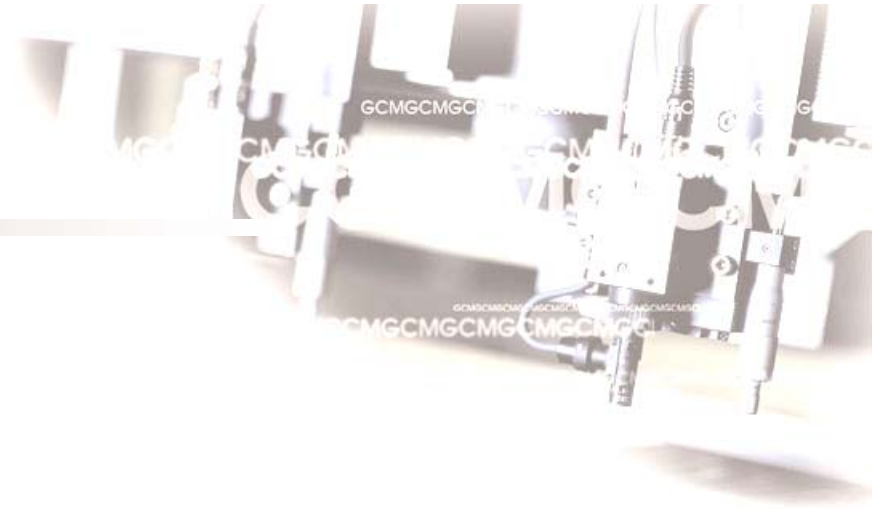


2006年2月期中間



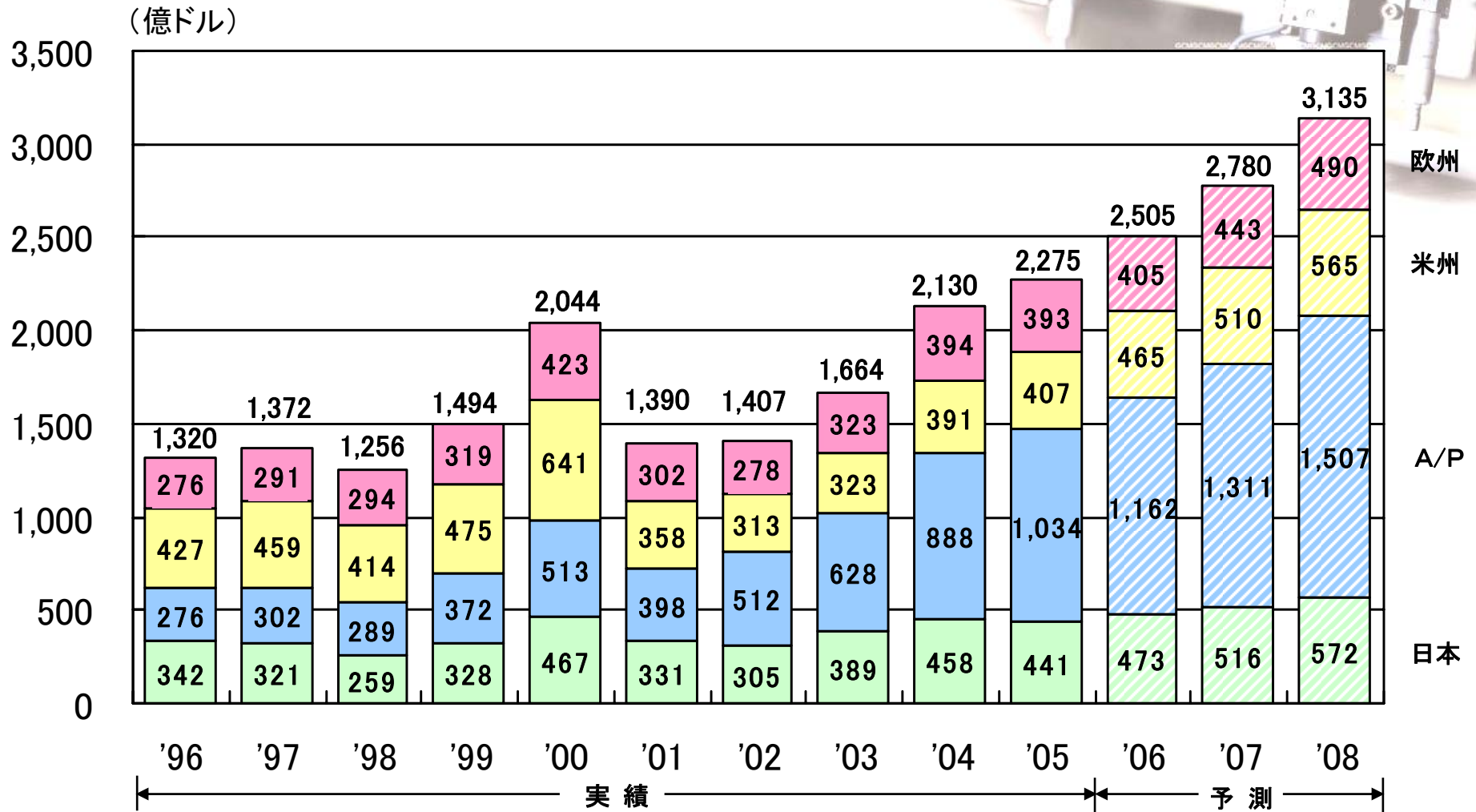
2007年2月期中間





2007年2月期 通期業績予想

世界の地域別半導体市場規模

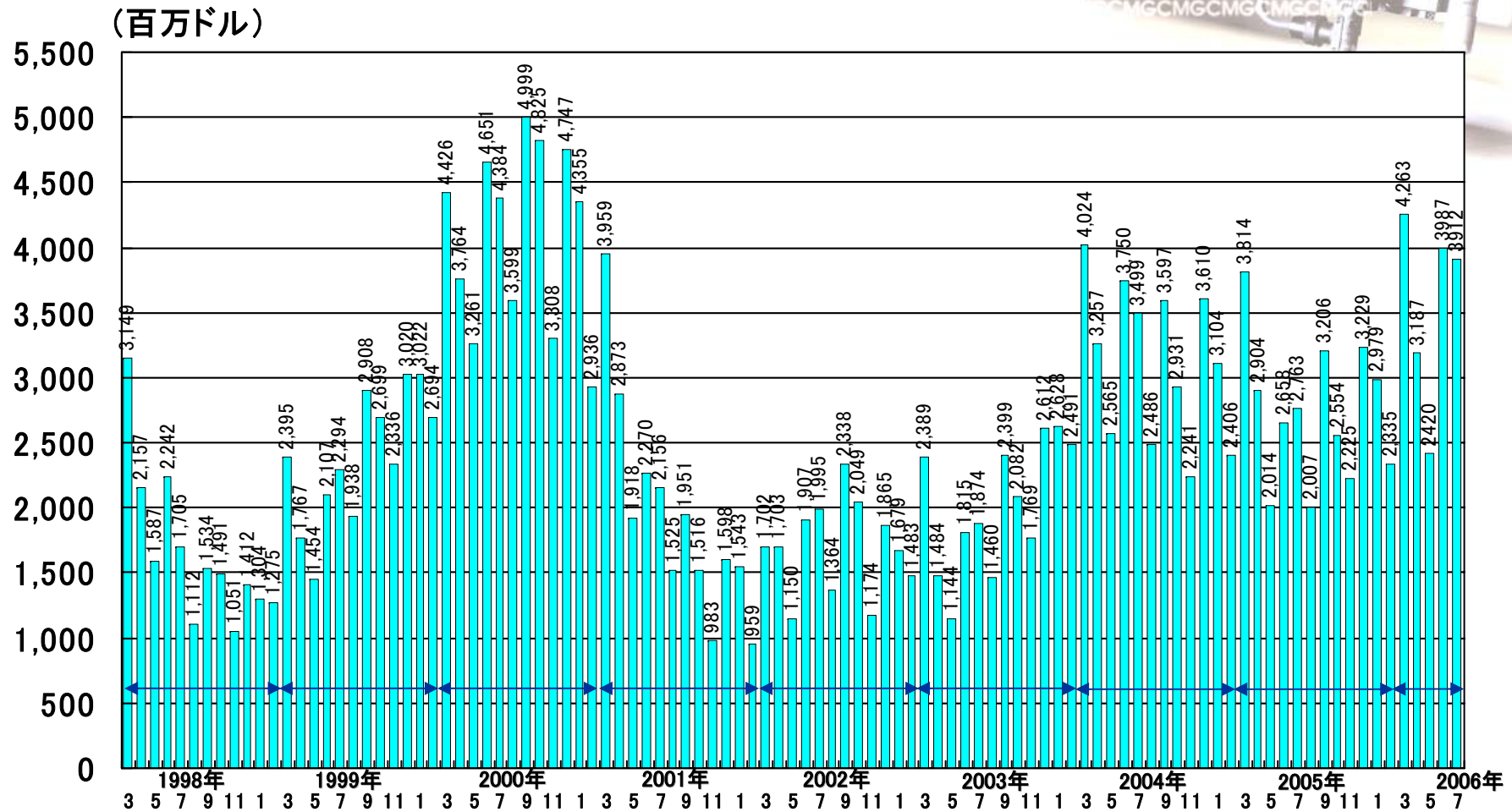


注:「A/P」はアジア・パシフィックの略

(出所:2006年6月14日付 半導体産業新聞) (2006年6月 WSTS発表)

世界規模 半導体製造装置販売統計

(2006年7月末現在)



(出所：SEA J, SEMI, SEMIジャパン)

2007年2月期 連結通期業績予想

(百万円)

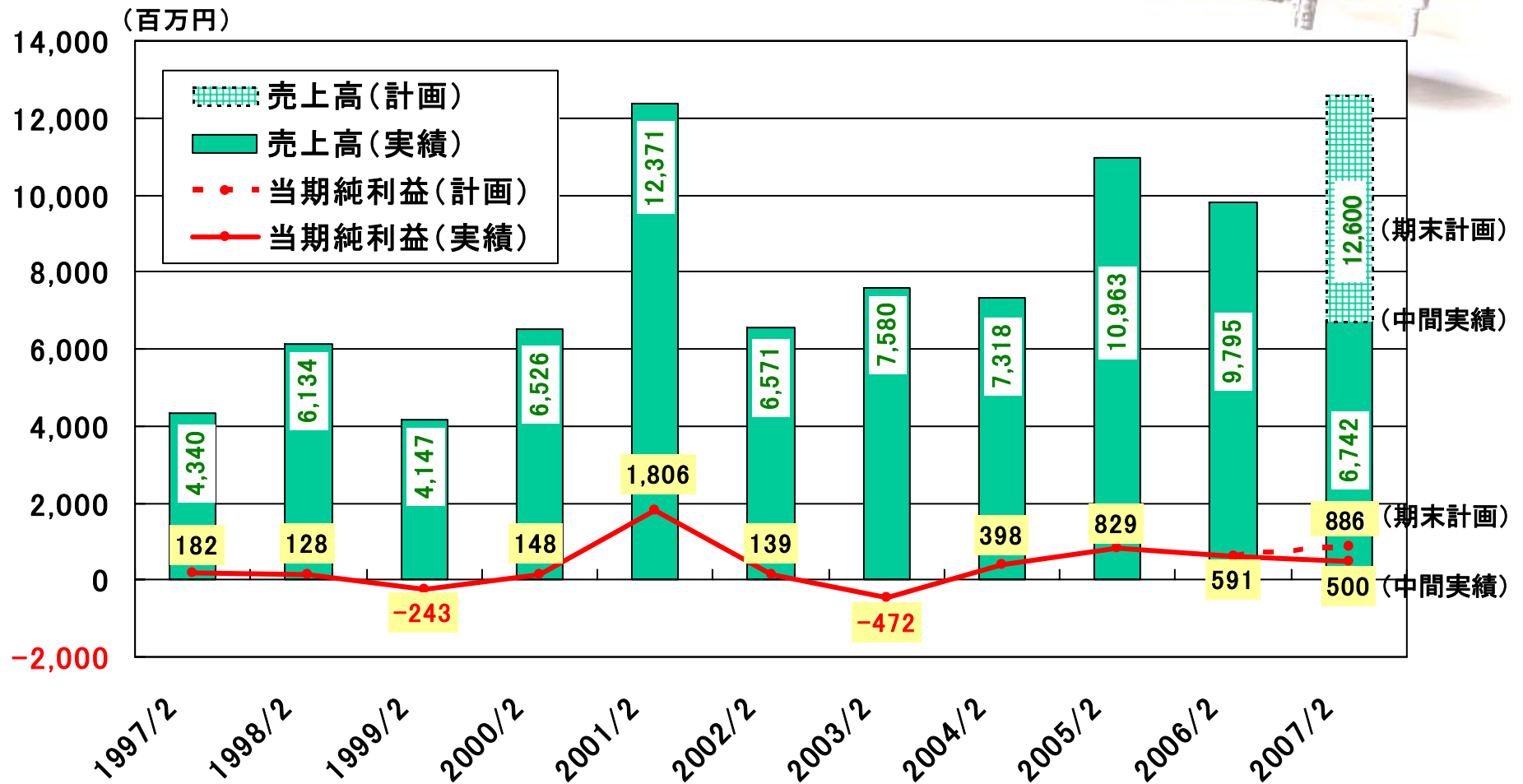
	2006年2月期 通期実績	2007年2月期 中間実績	2007年2月期 通期予想
売上高	9,795	6,742	12,600
売上総利益	2,757	1,862	3,518
販管費	1,778	1,012	1,900
営業利益	978	850	1,618
経常利益	902	843	1,470
当期(中間)純利益	591	500	886

2007年2月期 単体通期業績予想

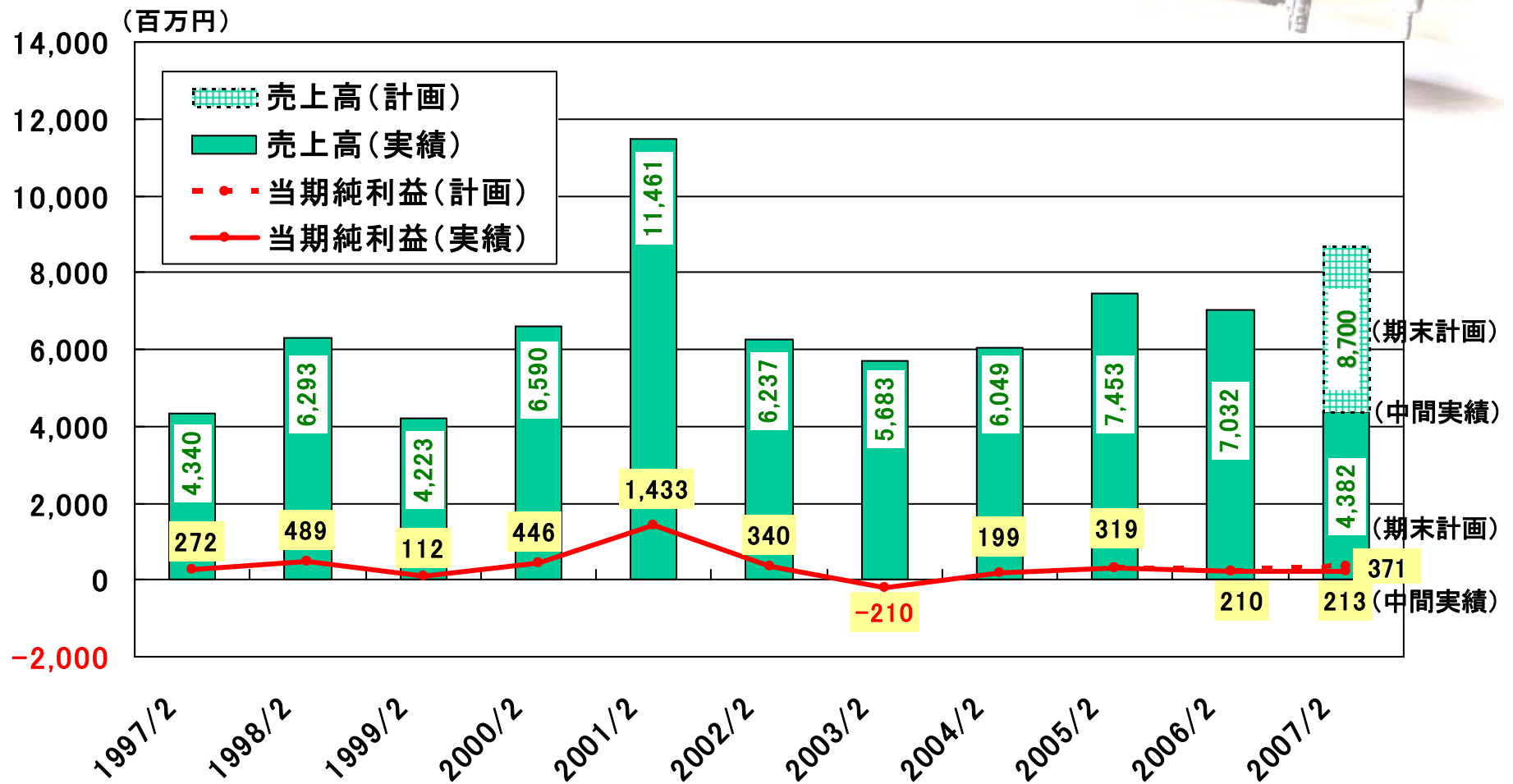
(百万円)

	2006年2月期 通期実績	2007年2月期 中間実績	2007年2月期 通期予想
売上高	7,032	4,382	8,700
売上総利益	1,491	925	1,897
販管費	1,041	523	1,066
営業利益	449	401	831
経常利益	376	374	672
当期(中間)純利益	210	213	371

連結業績の推移



当社(単体)業績の推移



新竹科学工業園区内で売上成長率トップ

工商時報 2006年9月12日



The A to Z of AZ
A Major Supplier of Innovative Products to The Semiconductor Industry.
ENGINEERED TO THE TOUGHEST STANDARDS. YOURS.

半導體設備材料展專刊

台灣IC構裝材料業 錢景旺

明年市場規模上看1197億元

一〇〇五年台灣IC構裝產業的成長一動脈主要來自於消費性電子產品及新興市場的大量需求，各季表現呈一季比一季好的態勢；不但手機、MP3 Player、MP等3C產品需求變強，第三世界新興市場對中低階系統產品的需求，也隨時帶動了傳統封裝業務的應用，再加上年初時數供不應求的問題積極解決，4月台灣封裝產業的整體平均產能利用率已回升至八成以上，部份熱門封裝產品（驅動IC、中低階晶片組、通訊晶片等等）甚至已回升至九成水準。總計二〇〇五年台灣封裝產值為一七八〇億元，較二〇〇四年上升二二%。二〇〇六年上半年延續二〇〇五年成長力道，表現不遺餘力，但第二季開始仍受到淡季因素影響，產能利用情形下滑，第三季受傳統旺季之影響，廠商開始提高庫存後，會有向上成長之趨勢，預期二〇〇六年台灣封裝產值可達二〇〇〇億元。

二〇〇五年台灣IC構裝產業在景收連季成長的表現帶動之下，連帶使上游的IC構裝材料市場隨之上升，二〇〇五年台灣的IC構裝材料市場總額新台幣一〇一億元，較二〇〇四年增加一八%。若以構裝型態來看，高階機殼製程的比重不斷提升，使得錫球、IC載板及TCP、COF板的成長較為迅速，而台灣又是產品面最廣的主要生產國家之一，在LCD-TV出貨的帶動下，未來TCP與COF板的需求將大幅增加。預期二〇〇六年台灣IC構裝材料產業的市場可達新台幣一九七億元，二〇〇四年至二〇〇八年之年複合成長率則為十五、五%。

在導線架方面，因產業成熟且競爭激烈，加上部分產品仍以IC載板為晶粒的載具，使得導線架成長幅度不大，二〇〇五年僅有五%成長率。未來導線架將不易出現大幅度的成長趨勢。

金線則因與金價格不斷上漲，近來多改使用更廉價的金線以降低成本，同時在部分產品轉移到微細線製程減少金線的使用量。

載板材料方面也因產品設計不一，小發展，使得整體載板封裝產值連年減少，其中又以高階機殼製程的比重不斷上升之及ANC、NC的用量也隨產值成長。〇六年七月一日RoHS指令施行，對載板封裝產品需求將大為增加，錫球及IC載板以四成成長，表現最為亮麗。主要因為晶粒的機殼製程轉機，使得導線架的需求量大為提升，加上IC載板成長而帶動TCP與COF板的國際基板大廠也將陸續計畫的產能。

綜合來看，整體IC構裝產值在三大方向的應用材料製程產品，如GA、TCP、SIP等；二、IC載板載板、COF及COG；三、導線架、可變載板及無載板封裝將有高成長力道；但導線架載板、IC載板、只靠導線架作為晶粒載具，產值成長幅度不大，但仍保有一席之地。

（本文由工研院IEA提供，記者鍾麗娟報導）

樂華業績強強滾 服務全方位

【記者鍾麗娟／新竹報導】半導體世界聞名、日本品質認證獲第一的RORZE，在台設立子公司樂華科技，專門從事半導體晶圓、LCD基板的robot傳送設備的開發製造、銷售與售後維修服務。

RORZE所有的開發設備皆是集合經驗十足的研發團隊精心研發而成，針對不同的客戶需求量身設計，在業界已樹立良好的口碑。

樂華科技總經理佐佐木大輔（右圖，鍾麗娟攝）指出，「客戶第一」即是英文RORZE之意（日文翻譯為世界第二高峰），半導體要求之高精密、高純度、高潔淨度與極近零靜音的標準，正是RORZE致力的目標。該公司亦獲得「潔淨度第一」的美稱，除此之外RORZE還力加強CIM要求，可針對金屬內容需要量身打造，對人體分離設計亦有其獨到之處。此亦其在業界受好評的原因之一。

樂華科技有別於他廠，是唯一為客戶量身打造機台，並且提供完善軟體搭配的廠商，無論在操作、監控上，均獲得良好評價。為了強化在地服務，母公司RORZE特別委請兩位高級工程師駐台，指導在台工程師經驗與管理，實現了以提高顧客的價值與滿意度為目標。

該公司亦為一全球化之公司，其公司目前據點除台灣以外，另分布於美國、韓國、中國、新加坡、越南，產品銷售世界各地。佐佐木大輔於四年前來駐台，六十一年的他在半導體領域已有相當豐富的經驗。他表示，樂華科技近三年來運籌轉虧為盈，尤其今年成長幅度驚人，創下成長率高達二〇〇%傲人成績，其努力亦獲得母公司RORZE肯定。



RORZE 日本半導體晶圓設備指名使用

潔淨度第一

ローツェテクノロジーの業績が各方面で拡大

半導体業界で世界に名を馳せ、日本のウエハ搬送機首位のローツェは、台湾に子会社ローツェテクノロジーを設立している。

ローツェテクノロジーは半導体、LCD基板の搬送機及びソーターの開発、製造、販売、アフターサービス業務を専門に行っている。

ローツェの全ての開発設備は全て経験豊富な研究開発チームが一心に研究開発し完成したもので、異なる客先に対応し、業界で良好な評判を得ている。

ローツェテクノロジーの佐々木大輔社長(写真)は「客先第一」これが英語のRORZEの意味である、と言う。(日本語に訳すと世界で二番目に高い山という意味になる)半導体が要求する高精密、高純度、高クリーン度、及び誤差がゼロに近いという標準が、正にローツェが目標とするところで、ローツェは「クリーン度首位」という良い評判を得ている。

他にローツェが努力しているのはCIMを強化することで、企業内容に合わせてカスタマイズが必要な、自動化設計については他に追随を許さないところがある。これが業界で良い評価を得ている原因の一つである。

ローツェテクノロジーには他にも、カスタマイズ仕様の装置を製造し、その装置仕様に完全に合ったソフトを配備するメーカーという一面も有る。

勿論、操作・制御面双方で良好な評価を得ている。また、フィールドサービスを強化するため、ローツェ本社は特別に2名の上級エンジニアを台湾に駐在させ、台湾のエンジニアに対し指導と管理をさせて、顧客の満足度を上げることを実現した。

ローツェはグローバルな会社で、台湾以外にもアメリカ・韓国・中国・シンガポール・ベトナムに生産販売拠点がある。

4年前から台湾に駐在している佐々木社長は、半導体領域について豊富な経験を持っている。彼は、ローツェテクノロジーはここ3年で黒字幅が拡大し、特に今年度の伸びは驚異的で、成長率は200%に達する。この努力はローツェ本社にも認められていると言う。

RORZE

RORZE CORPORATION

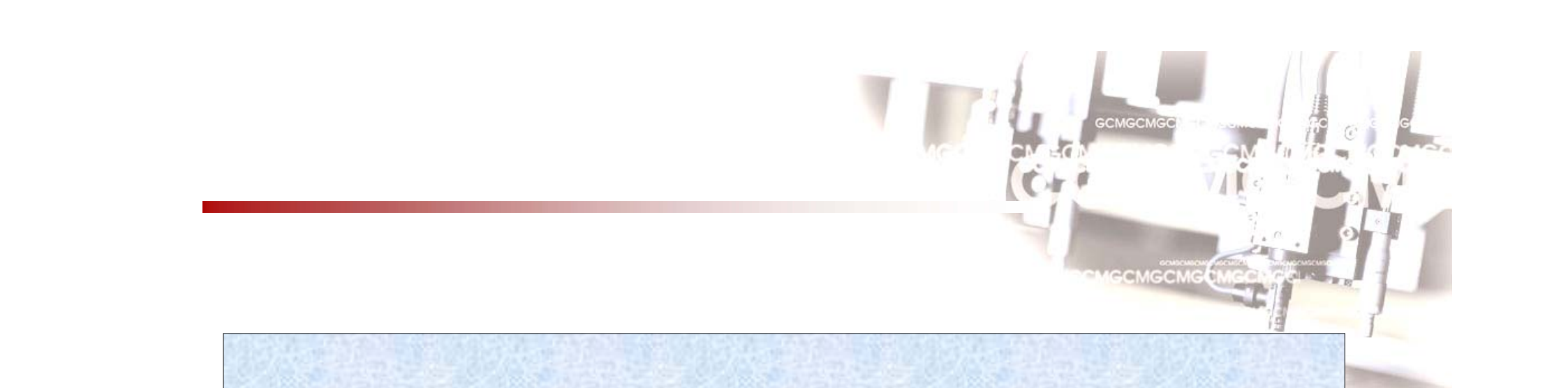
新竹科學工業園區内で売上成長率トップ

工商時報 2006年9月12日

RORZE 日本半導體晶圓設備指名使用
潔淨度第一名
晶圓搬送機 日本佔有率第一
LCD基板搬送機
CIM量身打造
半導體零配件生產
全方位在台服務
台積電 聯電指定使用
RORZE 樂華科技 股份有限公司
 總公司:
 新竹科學園區工業東四路12號2樓
 TEL:03-5776482
 FAX:03-5776481
 E-Mail:neillu@rorze.com.tw
 台中辦事處:
 台中市西屯區西屯路三段宏
 福五巷8號1樓
 TEL:04-24617709
 FAX:04-24619210
 台南辦事處:
 台南縣善化鎮中興路156號
 TEL:06-5815620
 FAX:06-5815595

新竹科学工業園区内で売上成長率トップ





注意事項

この資料は、決算の業績に関する情報及び将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれております。

これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した見通しや予測であり、その情報の正確性、完全性を保証したり約束したりするものではありません。

また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり、今後予告なしに変更されることがあります。